明新科技大學 封裝測試產業精英專班 113學年度 第1學期 課表

班級：產技子四甲 (2+2N)

科　目	必選修	學分/時數	任課教師
封裝能力鑑定(一)	必	3/3	趙守嚴
積體電路工程	必	3/3	沈添賜
半導體元件	必	3/3	張丞勛
Tester設備操作與維修概論	必	3/3	王木俊
Handler設備操作與維修概論	必	3/3	沈添賜
HF設備操作與維修概論	必	3/3	沈添賜
	合計	18/18	

明新科技大學電子系課程教學小組

電子工程系 主任 張丞勛

半導體學院 院長 張合

課表&教室	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
第一節 08:30~09:15	積體電路工程	半導體元件	半導體元件	半導體元件		Tester設備操作與維修概論	
第二節 09:15~10:00	積體電路工程	半導體元件	半導體元件	半導體元件		Tester設備操作與維修概論	
第三節 10:10~10:55	封裝能力鑑定(一)	積體電路工程	封裝能力鑑定(一)	半導體元件		Tester設備操作與維修概論	
第四節 11:00~11:45	封裝能力鑑定(一)	積體電路工程	封裝能力鑑定(一)	自習		Handler設備操作與維修概論	
第五節 11:45~12:30	封裝能力鑑定(一)	積體電路工程	封裝能力鑑定(一)	半導體元件		Handler設備操作與維修概論	
午休	午休	午休	午休	午休	午休	午休	午休
第六節 13:30~14:15	積體電路工程	半導體元件	積體電路工程	半導體元件		Handler設備操作與維修概論	
第七節 14:15~15:00	積體電路工程	半導體元件	積體電路工程	半導體元件		HF設備操作與維修概論	
第八節 15:10~15:55	封裝能力鑑定(一)	半導體元件	積體電路工程	積體電路工程		HF設備操作與維修概論	
第九節 16:00~16:45	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	積體電路工程		HF設備操作與維修概論	
第十節 16:45~17:30	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	封裝能力鑑定(一)	積體電路工程			

	一	二	三	四	五	六	日
w1				9月12日			
w2	9月16日						
w3		9月24日					
w4			10月2日				
w5				2024/10/10(休假)			
w6	10月14日						
w7		10月22日					
w8			10月30日				
w9				11月7日			
w10	11月11日						
w11		11月19日					
w12			11月27日				
w13				12月5日			
w14	12月9日						
w15		12月17日					
w16			12月25日				
w17				1月2日			
w18	2025/1/6(第45節-封裝能力鑑定(一)、第67節-半導體元件、第89節-積體電路工程						